



証券コード 6387

株主メモ

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	10月
基準日	7月31日
	上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
配当金支払株主確定日	期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日
単元株式数	100株
上場市場	東京証券取引所プライム市場
公告方法	電子公告とし、当社ホームページ (https://www.samco.co.jp/) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料) ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ (https://www.tr.mufg.jp/daikou/) でも承っております。

(ご注意)

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株主の皆さまの
声をお聞かせください

コエキク

当社は、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、アクセスキー入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。

<https://koekiku.jp> アクセスキー

スマートフォンからカメラ機能で
QRコードを読み取り

QRコードは株式会社デンソーウェーブ
の登録商標です。

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝を進呈させていただきます。

本アンケートは、株式会社プロネクサスの提供する「コエキク」サービスにより実施いたします。
アンケートのお問い合わせ「コエキク事務局」 ☒ koekiku@pronexus.co.jp



第45期の売上高・営業利益・当期純利益は過去最高となりました。 最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、 脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社第45期（2023年8月1日～2024年7月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。



左：代表取締役会長兼CEO

辻 理

右：代表取締役社長兼COO

川邊 史

第45期の事業環境、経営成績

半導体等電子部品業界におきましては、チャットGPTに代表される生成AI（人工知能）の急速な活用拡大等を背景に、ロジック半導体市場やメモリ市場で需要が回復いたしました。また、供給面でもここ数年で各国が自国での半導体の生産能力を急速に高めており、市場規模の拡大が続きました。このような環境の中、当社の関わる化合物半導体及び電子部品製造装置の販売マーケットにおいては、5G（第5世代移動通信システム）の普及に伴いその「高速・大容量」「低遅延」「多接続」という特色を生かした新たな事業領域での開発投資が進み、本格生産への移行が着実に進んでおります。加えて、6G（Beyond5G～普及が進んでいる5Gの性能をさらに進化させた次世代の移動通信システム）を中心とした情報ネットワーク基盤の実現に向けた世界最高レベルの研究開発環境の整備が進められており、研究開発向けの半導体等電子部品製造装置の需要が拡大しております。

このような状況の下、当社では化合物半導体分野での通信用・顔認証用・車載用の半導体レーザーやパワーデバイス用途、シリコン半導体分野では欠陥解析用途、電子部品分野では高周波フィルター用途など、研究開発用から生産用まで幅広い顧客への販売実績がありました。また、新規事業（ヘルスケア事業）の創出に向けた技術開発への取り組みや、水蒸気を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma（アクアプラズマ）洗浄装置による新たな事業領域の拡大に注力いたしました。

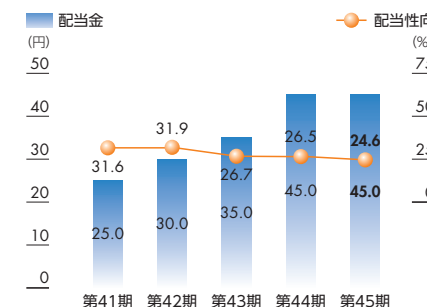
その結果、当期の国内売上高は4,408百万円（前期比14.3%減）となりました。国内ではデバイス・電子部品メーカー、大学、研究機関などで堅調な状況が続いております。一方、当期の海外売上高は3,794百万円（前期比41.3%増）と大幅に伸ばいたしました。アジア、北米を中心とした海外メーカー、大学、研究機関など幅広い地域や顧客からの販路拡大への注力が成果に結び付いております。海外売上高比率は46.3%まで高まり、中長期的に目標としている海外売上高比率50%に向け、更なる海外事業の拡大を推進してまいります。

続いて、当期の受注高は8,146百万円（前期比0.9%減）となりました。部材調達の長期化の影響が残るものの、装置受注から出荷までのリードタイムを短縮すべく、DXを活用した受注予測に基づく見込み生産を始めとする生産体制の整備、見直しを進めております。その結果、当期末の受注残高は5,361百万円（前期比1.0%減）となり、次期好スタートの準備が整っております。

以上の結果、当期における業績は、売上高8,203百万円（前期比4.8%増）、営業利益2,017百万円（前期比8.5%増）、経常利益2,088百万円（前期比8.4%増）、当期純利益1,471百万円（前期比7.7%増）となりました。

なお、期末配当金につきましては、経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続する基本方針のもと、1株当たり45円00銭とさせていただきます。

■ 配当金・配当性向



中期経営計画の進捗

前期（第44期）よりスタートした3カ年の中期経営計画を推進中であり、第45期につきましては各利益率・利益金額では当初計画を上回る着地となりました。次期（第46期）では、売上高9,500百万円、当期純利益1,530百万円を目標に、全社を挙げて取り組んでまいります。

当社では、創業当初から半導体の材料の研究に組み込み、省エネや脱炭素社会の実現に貢献してまいりました。IoT、AIなどの技術革新に伴い、サムコの“薄膜技術”から生み出される様々な製品は省エネや脱炭素社会の実現に向けて、ますます必要とされるものとなっております。最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

株主、取引先、従業員等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指し、成長力と収益力の向上を図り、適切な利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



サムコ株式会社とは？

サムコは京都市伏見区に本社を置く**半導体等電子部品の製造装置を手掛けるメーカー**です。半導体や電子部品は皆様の快適な暮らしには欠かせないものとなり、当社では薄膜を形成するCVD装置・ALD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面をクリーニングする洗浄装置などの独自の製品を世界中に提供しています。

社名の**SAMCO(サムコ)**は、**Semiconductor And Materials COmpany**の略で、半導体と材料開発の分野で躍進していくことを目指して名付けられています。



グローバルに事業を展開

1979年の創業以降、世界各国でグローバルに事業を展開し、現在はアジア、北米を中心に支店や子会社、販売代理店など、海外に11拠点を有しております。また、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供すべく、「直接販売」を行っており、京都から独自の製造装置を世界中に送り続け、これまで**世界35ヵ国に4,500台の装置を販売**してきました。



サムコが注力する化合物半導体とは？

当社は半導体の中でも“**化合物半導体**”と呼ばれる材料に特化した装置メーカーです。化合物半導体は、一般的な半導体デバイスで使用されているシリコン（珪素）とは異なり、複数の元素を組み合わせることで作られる半導体で、高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っています。



サムコはこれらの材料向けの製造装置を提供しています



サムコの装置はどのような製品・技術に活かされている？

化合物半導体の加工や様々な電子部品の製造に、当社の装置が使われており、今後も市場の拡大が見込まれています。**当社の装置を使って製造されるデバイスや最終製品の事例**をご紹介します。

	製造されるデバイス	最終製品の事例
化合物半導体分野	LD (半導体レーザー) / パワーデバイス	データセンター / 5G・次世代通信、光通信
電子部品分野	各種電子部品 (高周波フィルタ、センサ類)	スマートフォン・ウェアラブル端末 / 自動運転・電気自動車

省エネ・脱炭素社会を支えるサムコの技術

化合物半導体が用いられるLEDや次世代パワーデバイスなどは、当社の“**薄膜技術**”が活かされた装置によって製造されており、**当社は省エネ・脱炭素社会を支えているメーカー**であると言えます。持続可能な社会の実現に向けて、サステナブルな企業価値創造を目指し事業を展開しております。

詳しくは当社ホームページ
<https://www.samco.co.jp/ir/info/csr/>



TCFD | TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

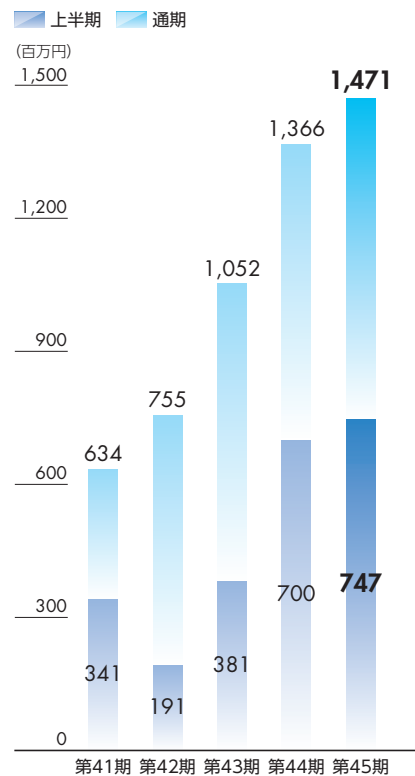
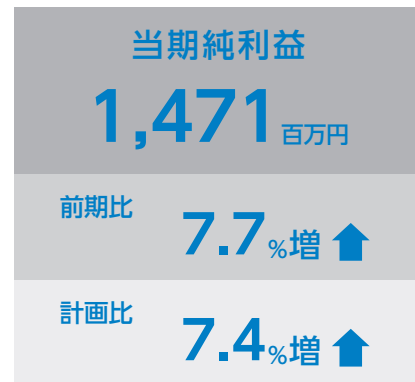
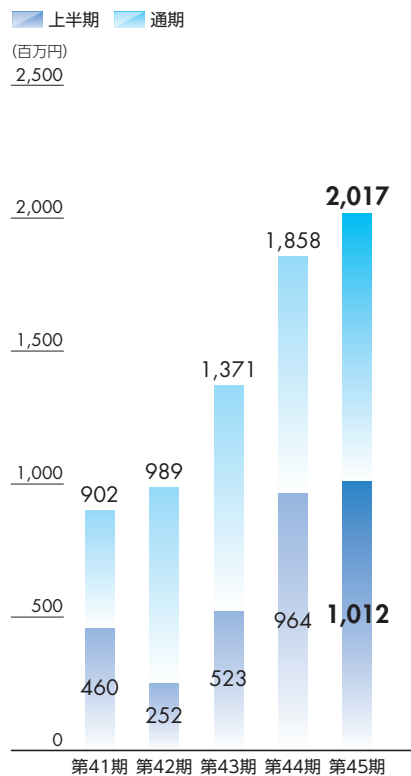
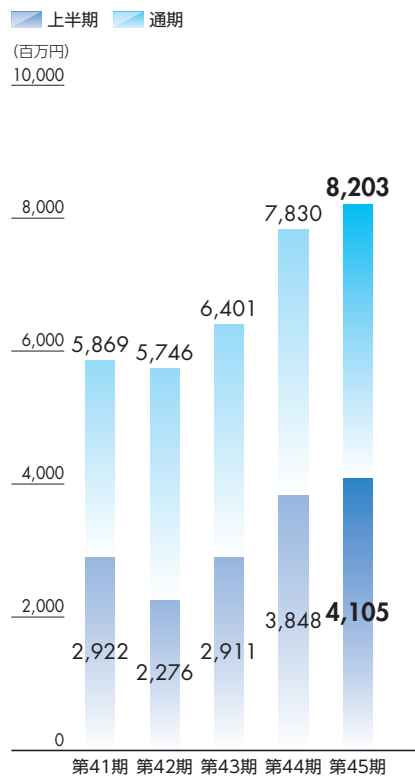
広報誌サムコナウの紹介

当社では、「**研究者の皆様と産業界の橋渡し**」をコンセプトにした広報誌**サムコナウ (samco NOW)**を四半期ごとに発行しています。ユーザーの皆様へのインタビューや、京都のお食事処など盛り沢山の内容となっており、バックナンバーも公開しておりますので、ぜひアクセスをお願いします。

<https://www.samco.co.jp/company/samconow/>



決算ハイライト



財務諸表

貸借対照表

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (2024年7月31日現在)	前期 (2023年7月31日現在)
(資産の部)		
流動資産	11,188,327	10,175,585
固定資産	4,927,698	4,619,445
有形固定資産	4,096,707	3,863,459
無形固定資産	18,338	4,364
投資その他の資産	812,652	751,621
資産合計	16,116,025	14,795,031
(負債の部)		
流動負債	2,833,557	2,676,039
固定負債	982,675	974,736
負債合計	3,816,232	3,650,775
(純資産の部)		
株主資本	12,103,966	10,993,640
評価・換算差額等	195,827	150,615
純資産合計	12,299,793	11,144,255
負債・純資産合計	16,116,025	14,795,031

損益計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (自2023年8月1日 至2024年7月31日)	前期 (自2022年8月1日 至2023年7月31日)
売上高	8,203,159	7,830,591
売上原価	4,009,838	3,961,565
売上総利益	4,193,320	3,869,026
販売費及び一般管理費	2,176,159	2,010,032
営業利益	2,017,161	1,858,994
営業外収益	76,823	72,439
営業外費用	5,331	4,268
経常利益	2,088,654	1,927,165
税引前当期純利益	2,088,654	1,927,165
法人税、住民税及び事業税	617,229	570,239
法人税等調整額	△ 566	△ 9,202
当期純利益	1,471,991	1,366,127

キャッシュ・フロー計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (自2023年8月1日 至2024年7月31日)	前期 (自2022年8月1日 至2023年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,642,346	△ 189,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 292,170	△ 75,930
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,438	△ 325,194
現金及び現金同等物の期末残高	4,637,782	3,374,374

拠点開設

第三研究開発棟の地鎮祭を執り行いました

4月、自社施設敷地に建設を計画している第三研究開発棟の地鎮祭を執り行いました。

地鎮祭には、伏見区の城南宮を齋主に、当社取締役、執行役員、技術開発部員、施工業者、メディア関係者が参列いたしました。土地の神様に工事の開始を奉告する「地鎮の儀」では、盛砂に代表取締役会長の辻が齋鋤を入れ、土地の神様を鎮め工事の安全と事業の繁栄を祈願し、ご参列の皆様とともに建屋工事の安全、そして将来の成功を祈願いたしました。第三研究開発棟は12月中旬に完成を予定しております。



社会貢献

ウクライナ人道危機救援金への寄付を実施

当社では2001年の株式会社店頭上場以降、毎期の利益の一部を日本赤十字社などの各種団体に寄付する活動を続けております。ウクライナにおける人道危機が続く中、ウクライナや周辺国において救援活動に取り組んでおられる赤十字社の活動にお役立ていただくため、昨年に続き、日本赤十字社へ1,000万円を寄付いたしました。



海外事業

米国ジェームズ・マディソン大学の学生らに会社見学会を実施

3月、米国バージニア州のジェームズ・マディソン大学で経営学修士(MBA)取得を目指す学生ら約40名が来社され、当社の歴史や事業内容を紹介する講演会と工場見学を実施いたしました。外部の教育機関による見学会の開催は5年ぶりとなりましたが、今後も国内外を問わずに外部との交流、情報交換の機会を積極的に増やしていく計画です。



社会貢献

京都の半導体産業振興、東高瀬川エリア活性化の取り組み

3月、京都リサーチパークにて京都府および(公財)京都産業21主催の京都半導体産業振興フォーラムにて、「半導体産業の展望と京都の可能性」と題したパネルディスカッションに代表取締役会長の辻が登壇いたしました。また、京都市成長産業創造センターにて、当社が位置する京都市伏見区の東高瀬川エリアに半導体やライフサイエンス関連企業を集積する「東高瀬川ビジネスコミュニティ」発足に際したシンポジウムが開催され、同団体の会長に辻が就任いたしました。

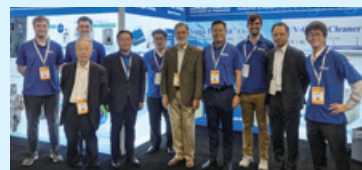
当社では、京都府や京都市などの地元の行政や近隣企業などと連携しながら、京都および東高瀬川エリアにおける地域産業の振興への取り組みも進めてまいります。



展示会

世界各国のSEMICONショーに出展

当社では重点課題の1つに「海外事業の拡大」を掲げており、海外での展示会にも積極的に出展をしております。昨年11月のSEMICON Europa (ドイツ)、昨年12月のSEMICON Japan (日本)、3月のSEMICON China (中国)、7月のSEMICON West (米国)、9月のSEMICON Taiwan (台湾)、SEMICON India (インド) などに出展し、最先端技術の紹介や製品発表などを実施しております。



SEMICON Westの当社ブース



社会貢献

サムコ科学技術振興財団が2024年度 第8回研究助成者10名に研究助成金を贈呈

サムコ科学技術振興財団は、第8回 薄膜技術に関する研究助成の対象者10名を決定し、9月20日に開催した研究助成金贈呈式において、それぞれ200万円、総額2,000万円を贈呈しました。式典後には、東京工業大学 元素戦略MDX研究センター 栄誉教授・特命教授で、物質・材料研究機構の特別フェローの細野秀雄様による記念講演が行われました。



■ 会社概要

商号 サムコ株式会社 (英文: SAMCO INC.)
 設立 1979年 (昭和54年) 9月
 事業内容 半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入
 資本金 1,663,687,288円
 従業員数 183名
 本社 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地
 TEL (075) 621-7841 FAX (075) 621-0936
 国内拠点 本社 (京都)、東日本営業部 (東京)、東海支店 (愛知)、つくば営業所 (茨城)
 海外拠点 米国 (カリフォルニア・ニュージャージー)、台湾、シンガポール、中国 (上海・北京)、マレーシア
 研究拠点 本社研究開発センター (京都)、オプトフィルムス研究所 (米国)

■ 役員 (2024年10月22日現在)

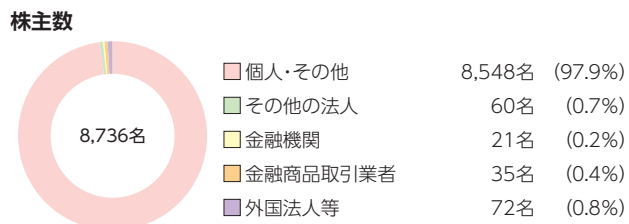
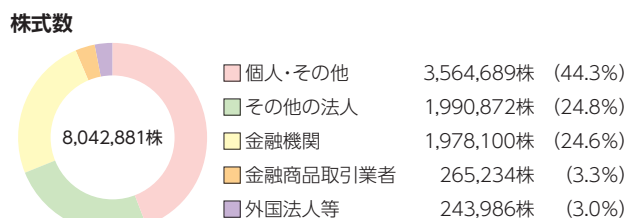
代表取締役会長兼CEO 辻 理
 代表取締役社長兼COO 川 邊 史
 取締役専務執行役員 山下 晴彦
 取締役執行役員 宮本 省三
 佐藤 清志
 社外取締役 村上 正紀
 高須 秀視
 藤田 静雄
 柳本 依子
 常勤監査役 辻村 茂
 社外監査役 西尾 方宏
 木村 学
 常務執行役員 外山 信一
 執行役員 松出 和男
 ヘンリー・チャン
 上杉 能章
 江崎 裕二
 奥野 英治

■ 株式の状況

発行可能株式総数 14,400,000株
 発行済株式の総数 8,042,881株
 株主数 8,736名
 大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
(一財)サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
辻 理	863,707	10.7
サムコエンジニアリング(株)	850,282	10.6
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	786,400	9.8
(株)日本カストディ銀行(信託口)	338,100	4.2
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行(株)(投信口)	159,400	2.0
(株)三菱UFJ銀行	129,600	1.6
サムコ従業員持株会	105,338	1.3
立田 利明	103,099	1.3

■ 所有者別株式分布状況



株主各位

京都市伏見区竹田藁屋町36番地
 サムコ株式会社
 代表取締役社長 川 邊 史

第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第45期 (2023年8月1日から2024年7月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件
 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通配当として1株につき45円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、取締役として辻 理、川邊 史、山下晴彦、宮本省三、佐藤清志、村上正紀、高須秀視、藤田静雄、柳本依子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村上正紀、高須秀視、藤田静雄、柳本依子の各氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、監査役として辻村 茂、西尾方宏、木村 学の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西尾方宏、木村 学の両氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、同封の「第45期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、裏面記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局 (銀行代理業者) において払渡し期間内 (2024年10月23日から2024年11月29日まで) にお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「第45期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上